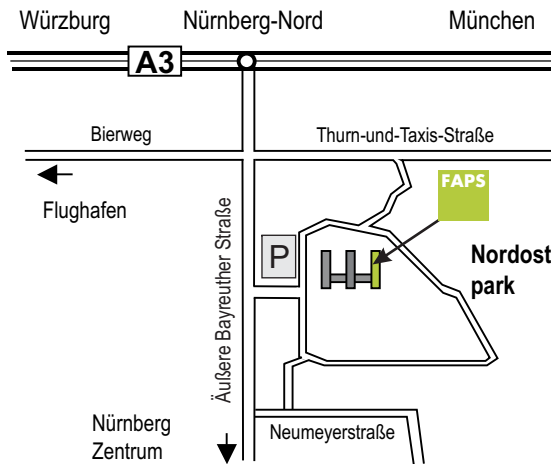


Bitte senden Sie uns die ausgefüllte
Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail

- im Umschlag an die vorgedruckte Adresse
- per E-Mail an service@faps-tt.de
- per Fax an 09131 / 302528



Veranstaltungsort:

Das Seminar und die Laborpräsentation finden in der
Forschungsfabrik Nürnberg, Nordostpark 89, mit dem
Labor zur Elektronikproduktion statt.

Anmeldung:

Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung mit
Vorlage der Anmeldebestätigung. Verwenden Sie bitte
zur Anmeldung die vorgedruckte Antwortkarte. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Registrierung erfolgt
nach Eingangsdatum.

Teilnahmegebühr und Leistungen:

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 340,- € zzgl. MwSt. ist
nach Rechnungsstellung auf das dort angegebene
Konto zu überweisen und schließt Tagungsunterlagen,
Pausengetränke und Mittagessen mit ein.

Rücktritt:

Bei Rücktritt bis zu 10 Tagen vor dem Seminar erheben
wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,- €. Nach dieser
Frist ist die Teilnahmegebühr gemäß Rechnung zu
zahlen. Die Seminarunterlagen werden dann zugesandt.

Weitere Informationen:

FAPS-TT GmbH
Prof. Dr.-Ing. J. Franke
Telefon: 09131 / 85 27971
Telefax: 09131 / 302528
E-Mail: service@faps-tt.de

Fachseminar zur
Elektronikproduktion

**Aktuelle Entwicklungen zur
Aufbau- und Verbindungstechnik**

- Materialien, Komponenten und
Fertigungsprozesse
- Neue Herausforderungen in der
Elektronikproduktion
- Referenten aus Industrie und
Wissenschaft

1. Dezember 2010

Nürnberg

Forschungsfabrik
Nordostpark 89

Fachliche Leitung:

Prof. Dr.-Ing. J. Franke,
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

**Ich melde mich an für das Fachseminar
Elektronikproduktion, 1. Dezember 2010**

Titel, Vorname, Name

Firma

Abteilung

Tätigkeitsbereich / Themenfeld

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Antwort

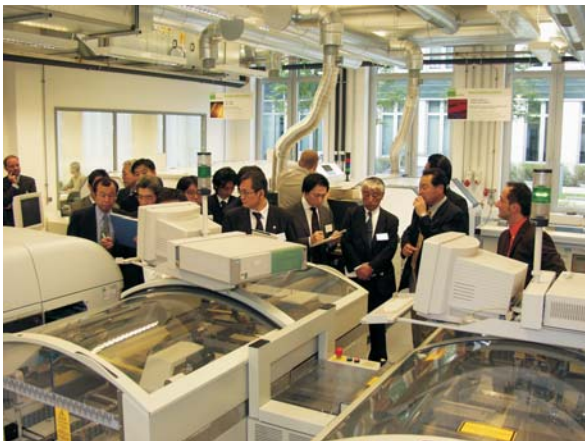
FAPS-TT GmbH
- Elektronikproduktion -

Fürther Straße 246
90429 Nürnberg

Entwicklungen zur Aufbau- und Verbindungstechnik

Die weitere Miniaturisierung elektronischer Bauelemente, die schnelle Einführung neuartiger Schaltungsträger und alternativer Verbindungstechnologien sowie die Produktion mit bleifreien Loten führen zu neuen Herausforderungen in der Elektronikproduktion. Für die Aufbau- und Verbindungstechnik gilt es, Anlagen und Prozesse anzupassen oder neu zu entwickeln. Diese weiterführende Optimierung erfordert innovative Strategien und neuartige Konzepte.

Im Rahmen dieses Seminars stellen erfahrene Experten aus Industrie und Forschung neue Ansätze zur Technologieoptimierung und ihre Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung vor. Entlang der Prozesskette Lotpastenauftrag, Bestücken und Löten werden aktuelle Schwerpunkte gesetzt sowie neue Herausforderungen in der Elektronikproduktion aufgezeigt.



Ziel der Veranstaltung ist es, einen aktuellen Informationstransfer mit Vorträgen, ergänzenden Fachdiskussionen sowie den Vorführungen in den Labors zu bieten. Das Forum in der Forschungsfabrik Nürnberg im Nordostpark mit dem Labor zur Elektronikproduktion bietet dazu beste Möglichkeiten.

Das Tagesprogramm bietet Gelegenheit zur Diskussion individueller Problemstellungen und spezifischer Sachfragen zur Aufbau- und Verbindungstechnik.

Programm

- 09:00 **Ganzheitliche Optimierung und gesicherte Teilprozesse in der Baugruppenmontage**
Prof. J. Franke, Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- Materialien und Komponenten**
- 09:30 **Spezielle bleifreie Lotpasten für erhöhte Zuverlässigkeit**
A. Miric, Director Product Line Automotive & Industrial
Microbond Assembly Materials
W. C. Heraeus GmbH, Materials Division, Hanau
- 10:00 **Aktuelle Trends in der Leiterplattenfertigung**
G. Georgiev, Projektingenieur
KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf
- 10:30 *Kaffeepause*
- 10:50 **Nächste Generation SAW Packages: Anforderung an Anlagen und Material**
Dr. J. Portmann, Director Process Development
EPCOS AG, A Group Company of TDK-EPC Corporation,
München
- Fertigungsprozesse**
- 11:20 **Qualitätsdatenanalyse zur Darstellung von Fehlerschwerpunkten im Schablonendruck**
M. Rösch, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 11:50 **Präzision und Flexibilität in der Mikromontage durch ein modulares Maschinenkonzept**
M. Thamm, Chief Marketing Officer
HÄCKER Automation GmbH, Schwarzhausen
- 12:20 *Mittagspause*
- 13:20 **Drahtbonden mit neuen Oberflächenmaterialien**
Dr. J. Sedlmair, Sales Coordination International
F&K Delvotec Bondtechnik GmbH, Ottobrunn

Programm

- 13:50 **Flexible Lötprozesse für die Umsetzung sich wandelnder Produkthanforderungen**
R. Diehm, Leiter Forschung und Entwicklung
SEHO Systems GmbH, Kreuzwertheim
- Neue Herausforderungen**
- 14:20 **Umweltsimulation zur Zuverlässigkeitsabsicherung bei KFZ-Elektronik**
G. Vogl, Leiter Automotive Quality Labs
Continental Automotive GmbH, Regensburg
- 14:50 *Kaffeepause*
- 15:10 **Stay cool - Kühlung von Leistungskomponenten und deren Einfluss auf die Lebensdauer**
Dr. U. Scheuermann, Manager Product Reliability
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nürnberg
- 15:40 **Angepasste Kontaktierungsverfahren für Flip-Chips mit kleinsten Lötstellengeometrien**
F. Schüßler, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 16:10 **Gedruckte Elektronik - Status und Applikationen**
K. Ludwig, Product Manager PolyLogo
polyIC GmbH & Co. KG, Fürth
- Systemlösungen entwickeln und erproben**
- 16:40 **Laborpräsentationen**
Im Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion mit temperierter Versuchshalle, Reinraum und Prüflabors werden alternative Systemlösungen zum Lotpastenauftrag, Bestücken und Löten mit prozessbegleitender Qualitätssicherung vorgestellt.
- 17:40 **Abschlussdiskussion**

Falls Sie spezifische Fragen oder Interessen haben - nennen Sie uns Ihre Anliegen gerne vorab.